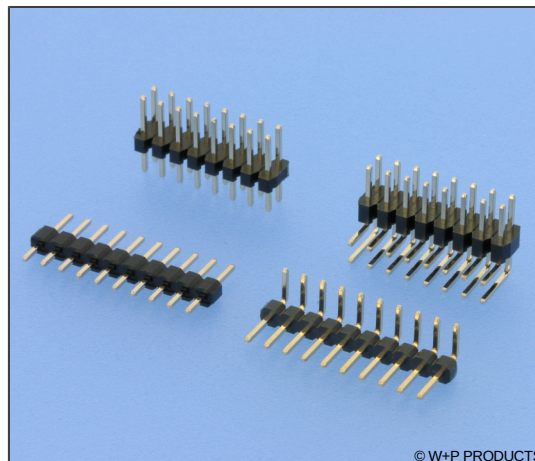


Stiftleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig

Pin Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row

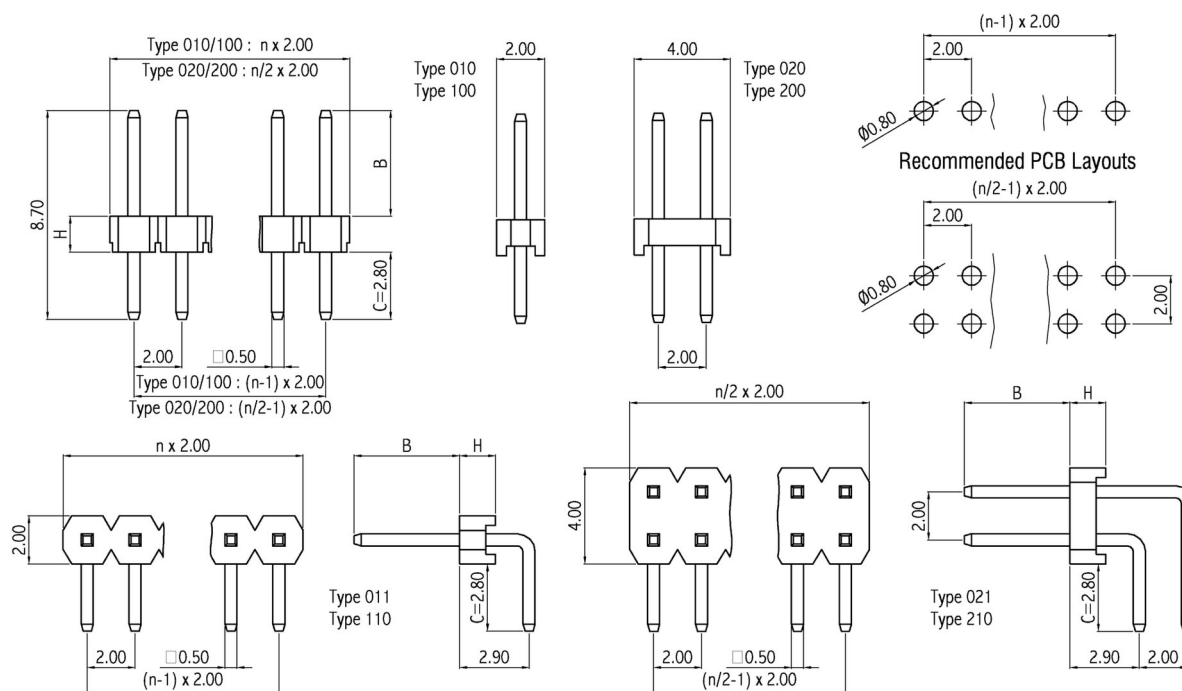
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.50mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	none
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Withstanding Voltage	1 kV DC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
316 744 416 518 (Crimp) etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series

314

314 Gestanzte/geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts

Type*

011

010/020 Gerade $H=2.00$ $B=3.90$ mm
Straight $H=2.00$ $B=3.90$ mm
100/200 Gerade $H=1.50$ $B=4.40$ mm
Straight $H=1.50$ $B=4.40$ mm
011/021 Gewinkelt $H=2.00$ $B=3.90$ mm
Right-angled $H=2.00$ $B=3.90$ mm
110/210 Gewinkelt $H=1.50$ $B=4.40$ mm
Right-angled $H=1.50$ $B=4.40$ mm

Contacts*

040

001-040 Einreihig
Single row
002-080 Zweireihig
Double row

Plating*

60

00 Vergoldet
Gold plated
50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 4,00mm, 6,00mm, etc. oder Sonderraster auf
Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten"
unter Techn. Informationen.
We will manufacture the pin headers in every desired
number of contacts. 4.00mm, 6.00mm, etc. and other
itches by request. Order page "Customer-specific Pin
Configurations" in Technical Information.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

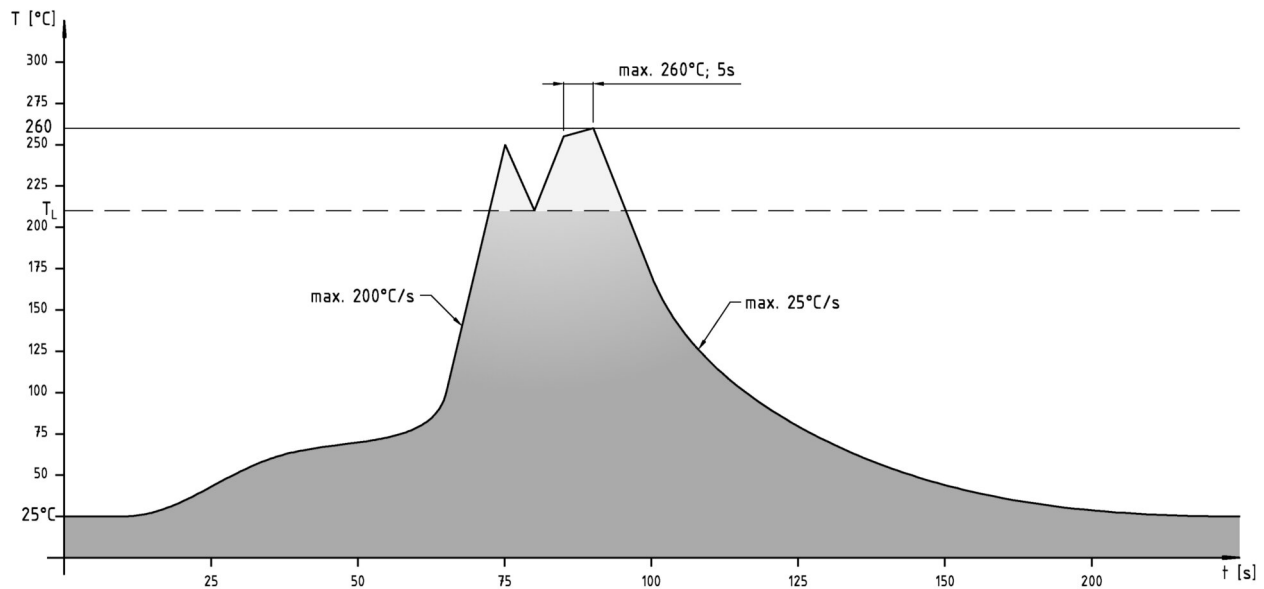
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25 °C - Peak Temp. T_P	max. 8min

